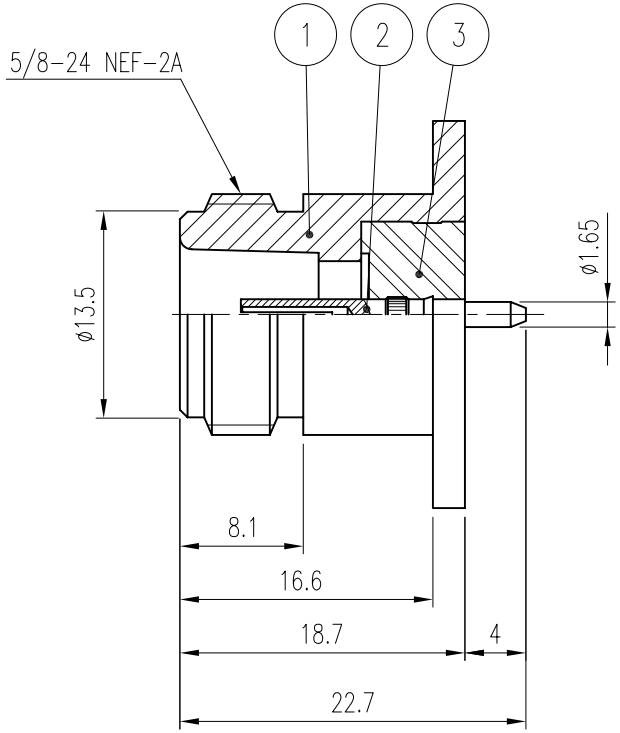
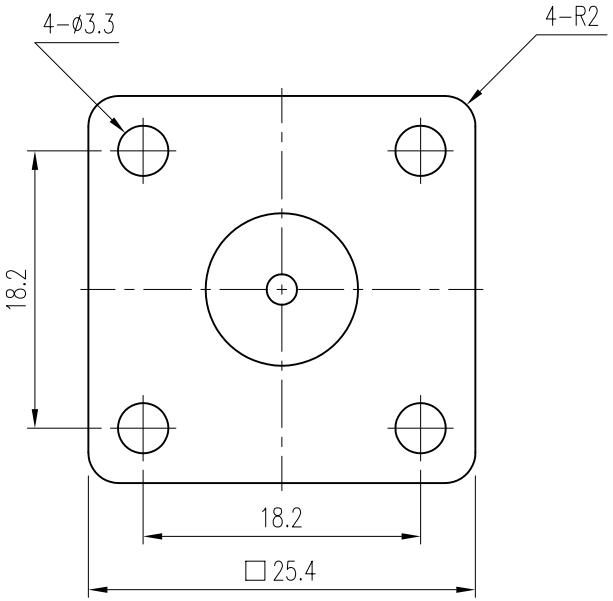
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00766-N/1 (H8532)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01731-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD02207-5/1
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

주 기

1. 조립시 BODY 플랜지 면에서 절연체가 돌출되지 않도록 할 것.

대체가능재질			
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2008. 10. 21.	
	승인		
	검도		
재질	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	
보호피막처리	척도 2/1	단위 mm	중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 N75-J-H4-R

A4

도번 CN02207-7/1